

Wärmeleitende EMV-Abschirmfolien

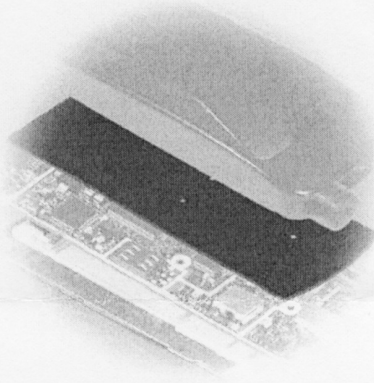
Hochfrequente Schaltvorgänge in der Elektronik erfordern die Unterdrückung elektromagnetischer Einstrahlungen über einen weiten Frequenzbereich. In der Leistungselektronik treten diese Einstrahlungen insbesondere durch unerwünschte aber technisch unvermeidbare Oberwellen oder bei schnell getakteten Leistungsmodulen auf. Ebenso erzeugen elektronische Hochleistungsbauelemente in Computern hochfrequente elektromagnetische Störstrahlung.

KU-EC und KU-K/CU/K Abschirmfolien erfüllen die hohen gestellten Anforderungen an die Dämpfung dieser Einflüsse indem die auftretenden elektromagnetischen Einstrahlungen durch Ableitung bei den Typen KU-EC/A, KU-EC/BM und KU-K/CU/K oder durch Absorption bei KU-EC/E erheblich reduziert werden. Dadurch, dass die Folien auch wärmeleitend sind, wird der thermische Gesamtübergangswiderstand sehr klein und Bauteile gefährdende Überhitzungen können vermieden werden.

Anwendungen (Auswahl)

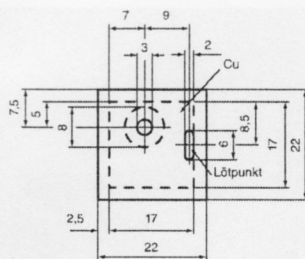
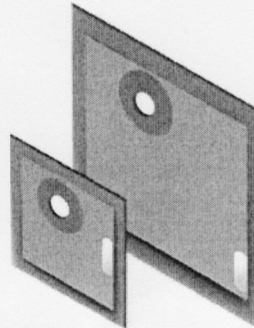
- Unterdrückung elektromagnetischer Einstrahlungen durch Einsatz bei
- Schnell getakteten Netzgeräten
 - Zwischen PCB und Gehäuse
 - LSI und Kühlkörpern
 - Transformatoren
 - Flachbandkabel
 - Leiterplatten
 - Telekommunikationsmodulen
 - Operationsverstärker

Alle Angaben erfolgen
ohne Gewähr
Technische Änderungen
vorbehalten

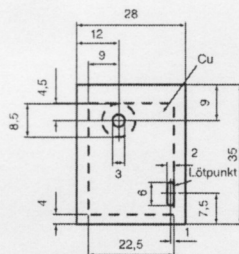


EMV-Ableitende Folien KU-K/CU/K

HEATPAD® KU-K/CU/K ist eine dünne Kupferfolie, die beidseitig mit Polyimidfolien elektrisch isoliert ist. Die Kupferfolie hat einen freien Punkt, der lötfähig ist und zur Ableitung der elektromagnetischen Einstrahlungen mit Masse verbunden wird. Die geringe Dicke und die gute thermische Leitfähigkeit des Materials tragen zu einer deutlichen Verringerung des thermischen Gesamtübergangswiderstandes bei. Somit werden Bauteile gefährdende Überhitzungen bei gleichzeitiger Dämpfung der elektromagnetischen Einstrahlungen durch Ableitung vermieden. Besonders eingesetzt werden sie in hochfrequent getakteten Netzgeräten als wärmeleitende Isolierung mit hoher Abschirmwirkung.



Art.-Nr KU 6-623/K/CU/K/TO-220



Art.-Nr KU 6-624/K/CU/K/TO-247/248

Eigenschaften

- Sehr hohe Abschirmung
- Gute thermische Leitfähigkeit
- Hohe Flexibilität
- Saubere und schnelle Verarbeitung

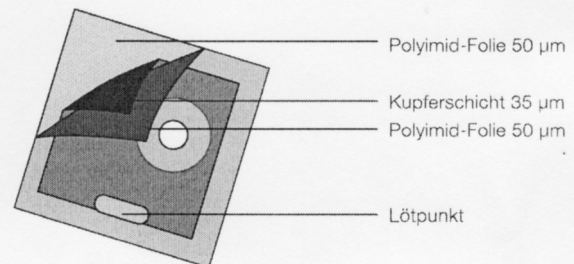
Lieferformen

- Für Standardhalbleitergehäuse TO 220 und TO 247/248/ auch ohne Loch für Klammersmontage

Auf Anfrage

- Sonderformen nach Kundenspezifikation

Aufbau einer K/CU/K-Folie



Technische Daten

| Folientyp | KU- | K/CU/K |
|---|------------------|------------------------------|
| Allgemeine Eigenschaften | | |
| Material Aufbau (Material verklebt) | | Polyimid - Kupfer - Polyimid |
| Dicke Kupfersubstrat | µm | 35 |
| Gesamtmaterialdicke | µm | 140 |
| Mechanische Eigenschaften | | |
| Zugfestigkeit | N/m ² | 124 |
| Elektrische Eigenschaften | | |
| Durchschlagsspannung | V | 4000 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | Ω m | 1,2 x 10 ¹² |
| Dielektrizitätskonstante | | 4,5 |
| Thermische Eigenschaften | | |
| Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 0,5 |
| Wärmeübergangswiderstand (inch ²) | °C/W | 0,5 |
| Betriebstemperatur | °C | -60 bis 200 |

Alle Maße in mm

Alle Angaben erfolgen
ohne Gewähr

Technische Änderungen
vorbehalten

Zur Herstellung der Erd-
verbindung haben alle
Typen einen Lötpunkt

Bestellbeispiel

KU 6-623 / K/CU/K
Artikel / Folientyp